ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
COMMUNICATION DEVICES
DIVISION
アルプス電気(株)
通信デバイス事業部御中

SPECIFICATION NO. 納入仕様書 NO.:

DATE

提出年月日 : 2009 年 2 月 9 日

SPECIFICATION

納入仕様書

	PRODUCT NAME	SAW FILTER
YOUR	品 名	声表面滤波器
貴社	PART NO.	
	部品番号	

	PRODUCT NAME	SAW FILTER(HDBF36A15Dc)
OUR	品名	声表面滤波器
弊社	COMMON SPECIFICATION NO.	
	共通仕様書 NO.	

RECEIVED 受領印欄			
RECEIVED			
	CFMD.	CHKD.	RCVD.
	ALPS FLF	CTRIC CO	I TD
ALPS ELECTRIC CO.,LTD COMMUNICATION DEVICES			
DIVISION			

MANUFACTURING NAME

SHOULDER ELECTRONICS LIMITED

₹

CFMD.	CHKD.		DSGD.	
確認	照	査	作	成
から	A	4	Korr	n

ALPS ELECTRIC CO., LTD. COMMUNICATION DEVICES DIVISION

アルプス電気(株)

PRODUCT NAME

通信デバイス事業部御中

SPECIFICATION NO. 納入仕様書 NO.:

DATE

提出年月日 : 2009年2月9日

SPECIFICATION

納入仕 様

YOUR	品 名	声表面滤波器	
貴社	PART NO.		
	部品番号		
	PRODUCT NAME	SAW FILTER(HDBF36A15Dc)	
OUR	品 名	声表面滤波器	
弊社	COMMON SPECIFICATION NO.		

SAW FILTER

F	RECEIVED 受領印欄					
	RECEIVED					
	CFMD. CHKD. RCVD.					
	ALPS ELECTRIC CO., LTD.					
	COMMUNICATION DEVICES					
	DIVISION					

PLEASE REFER TO BELOW

共通仕様書 NO.

下記変更点がありますので、よろしくご検討をお願い致します。

「記友文点がありようので、ようしてに検討さる限が、女しよう。					
ITEM	PRESENT CONTENTS	NEW CONTENTS	REASON/DELIVERY	DISCRIMINATION	
項 目	従来仕様	変 更 仕 様	変更理由及び納入時期	変更品の識別	
	_				

MANUFACTURING NAME

SHOULDER ELECTRONICS LIMITED

₹

CFMD.	CHKD.		DSGD.	
確認	照	査	作	成
カーチ	14	5_	Land	7

1.SCOPE 适用范围

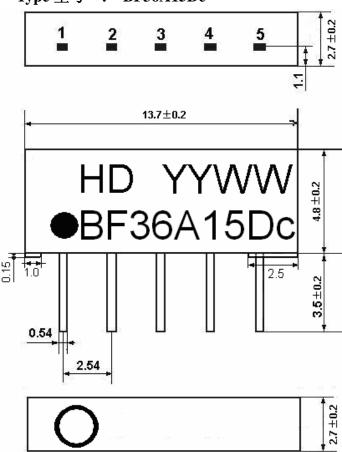
Bandpass filter for digital TV applications 应用在数字电视上的带通滤波器。

2.Construction 构造

2.1 Dimension and materials 外型尺寸及材料

Manufacturer's name :Shoulder Electronics Limited

Type 型号 : BF36A15Dc

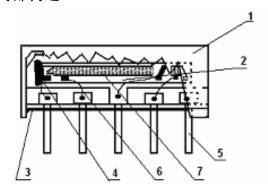


PIN configuration

- 1. Input
- 2. Input ground
- 3. Chip-carrier ground
- 4. Output
- 5. Output

YY: year WW: week

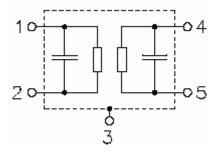
Internal 内部构造



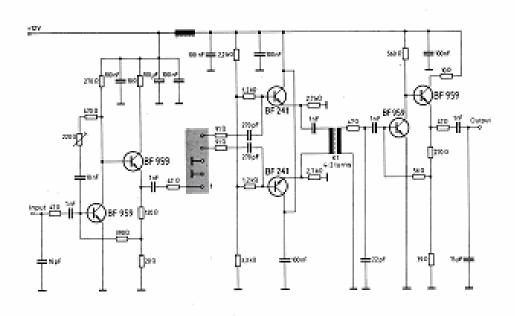
Components	Materials
1.Outer casing	PPS
2.Substrate	Lithium niobate
3.Base	Epoxy resin
4.Absorber	Epoxy resin
5.Lead	Cu alloy+Au plate
6.Bonding wire	AlSi alloy
7.Electrode	AI

材料名称	供应厂家
管座(塑封型)	无锡博精电子有限公司
管帽(塑封型)	无锡博精电子有限公司
晶片 (LN)	上海东城电子材料厂
硅铝线(Φ0.045mm)	常州日昱电子元件厂
胶粘剂(05-40)	上海牡丹油墨厂
油墨(05-40)	上海牡丹油墨厂
环氧树脂(9002GA/B)	无锡惠利精细化工厂

2.2Equivalent circuit 等效电路



2.3. Circuit construction, measurement circuit 测试电路



Test circuit for SIP-5 filter input impedance of the symmetrical post-amplifier: 2 k Ω in parallel with 3 pF

3.Characteristics 特性

Items	Conditions	Specifications
Standard atmospheric conditions 气候条件	Unless otherwise specified , the standard rang of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows; 除非另有说明,测试时将满足以下气候条件 Ambient temperature : 15℃ to 35℃ 环境温度 Relative humidity : 25% to 85% 相对湿度 Air pressure : 86kPa to 106kPa	
Operating temperature rang 工作温度	大气压 Operating temperature rang is the rang of ambient temperatures in which the filter can be operated continuously20℃ ~+85℃ 工作温度是滤波器连续工作时温度的范围	There shall be no damage. 无损坏
Storage temperature rang 存储温度	Storage temperature rang is the rang of ambient temperatures at which the filter can be stored without damage. 存储温度是滤波器存储时无损坏的温度范围 Conditions are as specified elsewhere in these specifications20℃ ~+85℃	
Reference temperature 参考温度	+25°C	

3.1 Maximum Rating 耐电压

DC voltage	VDC	12	V	Between any terminals 任意两引线脚之间
AC voltage	Vpp	10	V	Between any terminals 任意两引线脚之间

3.2 Electrical Characteristics 电器特性

Source impedance $Zs=50 \Omega$

Load impedance $Z_L=2k \Omega //3pF$ $T_A=25 ^{\circ}C$

T.		EZR // 5	1	1 ,	71	
Item		Freq	min	typ	max	
Center free 中心频		Fo	-	36.00	-	MHz
	Insertion attenuation					
插入损	耗	36.00MHz	19.5	21.0	22.5	dB
Reference	e level	30.00M11Z	17.3	21.0	22.3	uБ
参考电	1平					
Amplitude ri						
波动	•			0.7	1.0	
(32.45~39.5	55MHz)					
		B3dB	-	7.7	-	MHz
		B15dB	-	8.3	-	MHz
Relative atte	enuation	30.75MHz	40.0	48.0	-	dB
相对衰		40.25MHz	18.0	28.0	-	dB
14,3,2		40.75MHz	31.0	39.0	-	dB
		41.25MHz	34.0	43.0	-	dB
		31.80MHz			-	dB
Sidelobe		30.75MHz	34.0	39.0	-	dB
阻带抑制		45.0MHz	34.0	40.0	-	dB
Reflected w						
· ·]波信号抑制					
	5.0 us after r		40.0	50.0	-	dB
,	t pulse 250					
-	equency 36.	,				
	gh signal su					
	[通信号抑制			50.0		10
	2us before n			50.0		dB
(test pulse 250						
carrier frequency 36.						
Group delay rippl 群延迟波动			_	60	_	ns
	中延迟级约 2 0~39.80 M				-	113
Temperatur				-72		ppm/k

3.3Environmental Performance Characteristics 环境试验

Item 项目	Condition 条件	Specifications 说明			
High temperature 高温	The specimen shall be store at a temperature of 85 $^{\circ}$ for 1000h. Then it shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1h, after which measurement shall be made within 1h. 85 $^{\circ}$ 1000h,置于室温 1h	<u> </u>			
Low temperature 低温	The specimen shall be store at a temperature of -20 $^{\circ}$ C for 1000h. Then it shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1h, after which measurement shall be made within 1h20 $^{\circ}$ C, 1000h, 置于室温 1h				
Humidity 潮湿	The specimen shall be store at a temperature of 60 \mathbb{C} with relative humidity of 90% to 95% for 1000h. Then it shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1h, after which measurement shall be made within 1h. $60\mathbb{C}$, 相对湿度: 90% to 95%,1000h,置于室温 1h	Mechanical characteristics and			
Thermal shock 温度冲击	-20°C 20min \sim +80°C 20min 700 cycle	specifications in electrical characteristics			
Resistance to Soldering heat 耐焊接热	[Reflow heat resistance] For Pb-free Parts heat resist temperature profile Temperature (*C) 300 Temperatur Pre-heat area Peak temp. 3260°C Max 3sec 2206°C/s 190 Pre-heat 150~190°C 90±30sec (max120sec) 230°C 330°C	shall be satisfied. There shall be no excessive change in appearance. 机械特性和电特 性没有改变;外 观也没有明显的 改变。			
Electro static withstand strength 防静电	Standard:JESD22-A114-B, +/- pluses with 1s delay, 3 times, 2000V. Between two terminals.				
Solder ability	Immerse the pins melt solder at 260°C+5/-0°C for 5	More then 95%			

可焊性	sec.	of total area of
	浸没在温度 260℃+5/-0℃的焊锡中,持续 5 秒	the pins should
		be covered with
		solder
		焊锡覆盖面积大
		于 95%
		The area to be
		soldered
		specified to have
		1.0 mm
		minimum from
		root of lead
		焊锡离结构本体
		距离≤1mm

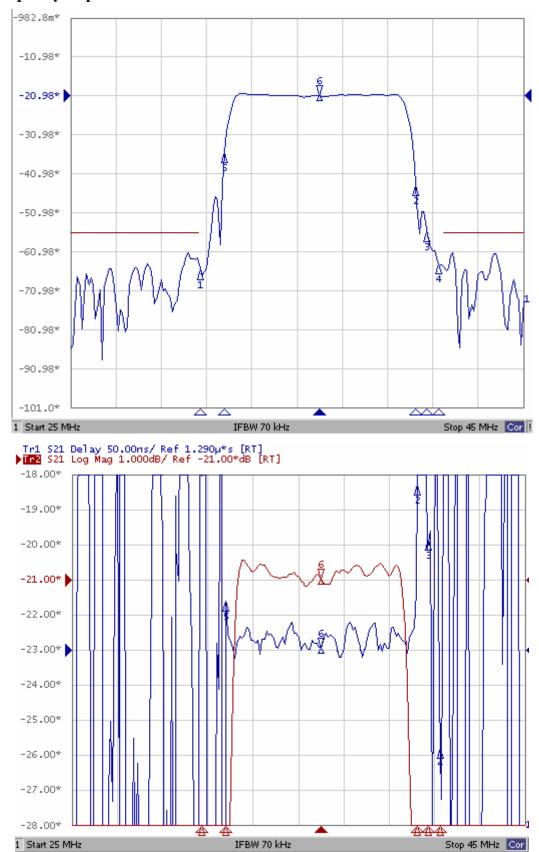
3.4 Mechanical Test 机械强度测试

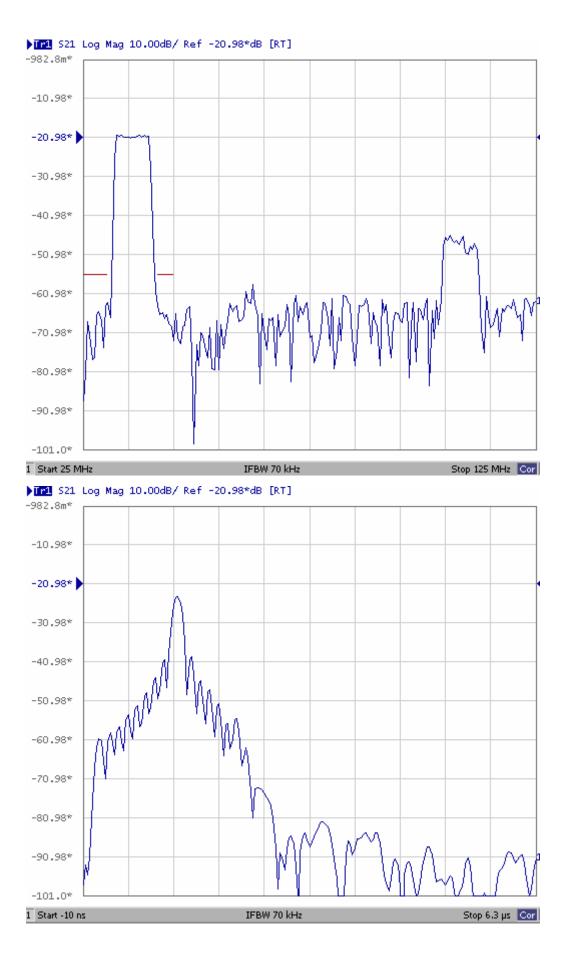
Items 项目	Conditions	Specifications
Vibration	600-3300rpm amplitude 1.5mm	
振动	3 directions 2 H each	
	600-3300rpm,振幅 1.5mm, 3 个方向各 2 小时	
Drop	On maple plate from 1 m high 3 times	There shall be no
跌落	木质地板, 高度 1m, 3 次	damage.
Lead pull	Pull with 1 kg force for 30 seconds	无损坏
引线脚拉力	轴向 1kg 拉力,持续 30 秒	
Lead bend	90° bending with 500g weigh 2 times	
引线脚弯曲	90°方向 500g 力,2 次	

3.5Voltage Discharge Test 放电测试

Item 项目	Condition	Specifications
Surge	Between any two terminals 两引线脚之间	
	100V 1000pF 4Mohm	There shall be no damage 无损坏

3.6 Frequency response



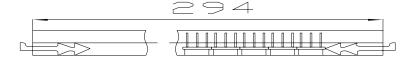


3.7 Package

Unit: mm

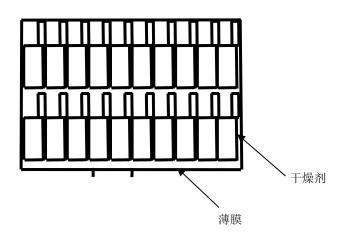
Pipe

20PCS /pipe



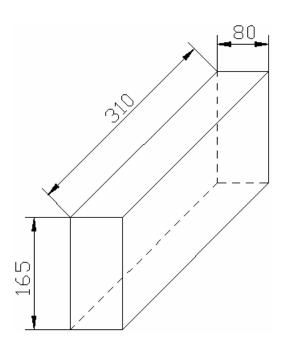
Pipes

 20×20 PCS



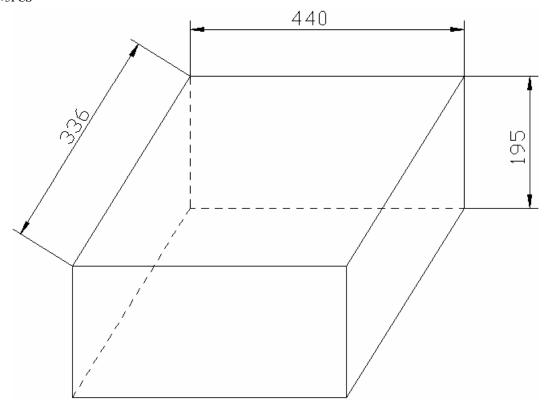
Inside Box

 400×5 PCS



Outside Box

 $2000 \times 5PCS$



Lot number:

<u>XX-XX-XX....</u>

A B C

A: Year 年

B: Month 月

C: Number 号码

For example: 05-10-66 means it's produced in Oct, 2005, and "C" is the number for ourselves checking when there's any quality problem;

Manufacturing address

Factory add: No 115, Gaoyun road, Binhu Economic & Technology Development Area, Wuxi, Jiangsu, China Tel:86-510-5629111 Fax:86-510-5627222

初版作成日: 2003. 7.10

電気・電子部品共通仕様チェックリスト(Ver. 10) TS 共通修正日: 2008. 6.30

Checklists for Purchasing Specifications for Electric and Electronic Components

適用範囲 Scope

供給者は、アルプス電気(株)通信デバイス事業部に納入仕様書を作成し提出する際に、これらリストを使用しなければならない

The suppliers shall be used to those lists, when they make the purchasing specifications and submit it to ALPS Electric Co., LTD. Communication Devices Division.

2. 目 的 Purpose

これらのチェックリストは、供給者が納入仕様書を作成中にこのチェックリストを活用し、納入仕様書上 適切な記載を行うために設けられたものである。

These lists are established to provide the appropriate descriptions on the purchasing specifications made by suppliers, as used for that the suppliers utilize the checklists while making the purchasing specifications.

3. チェックリストの種類と用途 Kinds of checklist and how to use.

本チェックリストは一般チェックリストとIC、クリスタル、SAWフィルターなどの部品に関する個々のチェックリストから構成される。下記にそのチェックリストの詳細を示す。

NOの場合 その理由を明確にして ALPS 側と協議して解決しなければならない。

The checklists consist of generic checklist and individual checklist for each component, such IC, Crystal, SAW filter etc.. The followings are detail for these checklists. The supplier shall take a solution to the problems with clearly reason in discussion with ALPS, if the check results were not acceptable.

種類	用 途
Kinds of checklist	Use
部品共通仕様 項目チェックリスト Generic checklist	① 電気・電子部品共通の仕様項目のチェックリストなので、納入仕様書提出時には常時使用する。 This generic checklist shall be always used, when suppliers make the purchasing specifications, because the checklist specifies generic requirements for electric and electronics components. ②チェックリストに基づき全項目チェックし、チェックした結果を納入仕様書提出時に添付する。 The suppliers shall submit the purchasing specifications along with the checked results, in completion of the check of all items described in the generic checklist.
品種別仕様項目 チェックリスト Individual checklist	① 電気・電子部品品種別の仕様項目のチェックリストなので、該当する納入仕様書の品種のチェックリストを選択して使用する。 The suppliers select the appropriate individual checklist corresponded to the applicable purchasing specifications, ②チェックリストに基づき全項目チェックし、チェックした結果を納入仕様書提出時に添付する。 The suppliers shall submit the purchasing specifications along with the checked results, in completion of the check of all items described in the individual checklist.
	半導体 Semiconductor
	水晶振動子&水晶発振器 Crystal Unit&Crystal Oscillator
	SAW-F, SAW-R Saw-filter, Saw-resonator
	セラミックフィルター、セラミックトラップ Ceramic filter, Ceramic trap
	チップコンデンサー Chip capacitor
	チップインダクター Chip inductor
	I F T Intermediate Frequency Transformer
	チップ抵抗 Chip Resistor
	可変コンデンサー Variable capacitor
	貫通コンデンサー Feedthrough capacitor
	イメーシ゛センサー Image Sensor

部品共通仕様項目チェックリスト

Generic check list

確認印 Check (1/6)

	項 目			Check		理由(Noの場合)	
NO.		Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no	
1	・最大定格は明記しているか Are the maximum ratings specified clearly?						
2	・動作条件 Are the o	は明確か perating conditions made clearly?					
	Are the k	メーターは仕様化しているか ey parameters made specifically?					
	一搬用 For general use	動作温度範囲は -20 °C \sim +85°Cを満足しているか Is the component satisfactory about operating temperature with the range from -20 °C to +85°C ?					
	車載用、 屋外用 For car use, outdoor use	動作温度範囲は -40 °C $\sim+85$ °Cを満足しているか Is the component satisfactory about operating temperature with the range from -40 °C to $+85$ °C ?(further discussion will be required, if used for car and/or outdoor unit)					
		は明記されているか torage temperature specified clearly?					
3		は明確になっているか lectrical characteristics specified clearly?					
		として回路、冶具、測定器等は規定してあるか easurement conditions including the circuits, jig and measurement instruments etc.					
	・信号レベル、温度範囲、湿度、電圧、電流等の測定条件下で特性値が変動する場合 項目毎に選択条件を明記してあるか Are the selected conditions for each item specified clearly, if the changes of Specified value occur in the measurement for signal level, temperature range, humidity ,voltage and current etc.?						
	・測定方法が JIS, JEITA 等、公の機関で決められていない御社独自の測定方法の場合、その測定条件 (例えば、信号レベル、温度範囲、湿度、電圧、電流等) を明記してあるか Are the selected conditions for each item specified clearly, if the changes of specified value occur in the measurement for signal level, temperature range, humidity voltage and current etc.?						

部品共通仕様項目チェックリスト Generic check list (2/6)

NO.		項 目 Items	Yes	Check No	N/T	理由(Noの場合) Reasons, if no
4	Is the spec	/耐久性 Reliability test / Durability (リフロ−半田耐熱など)で前処理した後、信頼性を行う規定になっているか ification specified that the reliability test would be carried out after nt with soldering conditions?				
		よ明確か teria for judgement made clearly?				
	一搬用、 屋外用 For general use, outdoor use	・耐湿通電負荷は定格電圧印加で+60℃/90~95%RH 1000H以上を満足しているか Does the component comply with the rated voltage biased and humidity test at +60℃ 90~95%RH for 1000hr or more? However, biased is unnecessary in the passive device				
	車載用 For car use	・耐湿通電負荷は定格電圧印加で+85℃/+85%RH 1000H以上を満足しているか Does the component comply with the rated voltage biased and humidity test at +85℃/+85%RH for 1000hr or more? However, biased is unnecessary in the passive device.				
		1000H にて動作するか mponent operate at +85℃ 1000hr?				
	一搬用 For general use	・−20℃ 1000Hにて動作するか Does the component operate at - 20℃ 1000hr?	•			
	車載用、 屋外用 For car use, outdo or use	・ $-40^\circ\mathrm{C}$ 1000H て動作するか Does the component operate at $-40^\circ\mathrm{C}$ 1000hr?	-			
	一般用 For general use	・高温放置+85℃ 1000H満足しているか Does the component comply with the requirements for high temperature storing test at +85℃ for 1000hr or more ?				
	車載用 For car use	・高温放置+110℃ 1000H満足しているか Does the component comply with the requirements for high temperature storing test at +110℃ for 1000hr or more ?				
	一般用 For general use	・低温放置-20℃ 1000H満足しているか Does the component comply with the requirements for low temperature storing test at -20℃ for 1000hr or more ?				
	車載用 For car use	・低温放置-40℃ 1000H 満足しているか Does the component comply with the requirements for high temperature storing test at-40℃ for 1000hr or more ?				

		項 目		Check		理由(No の場合)
NO.		Items ・TST(一般用)は-20℃/20 分~+80℃/20 分 700 サイクルを満足しているか	Yes	No	N/T	Reasons, if no
	一搬用 For general use	Does the component for general use comply with the requirements for thermal shock test (-20°C/20 minutes~+80°C/20 minutes) in 700 cycles?				
	車載用 For car use	・TST(車載用)は-40℃/30分~+85℃/30分2000サイクルを満足しているか Does the component for general use comply with the requirements for thermal shock test (-40℃/30 minutes~+85℃/30 minutes)in 2000 cycles?				
	Does the compo	引)は -40 °C/30分 \sim +85 $^{\circ}$ C/30分 700 サイクルを満足しているかonent for car and/or outdoor use comply with the requirements of 700 cycles of test (-40 °C/30 minutes \sim +85 $^{\circ}$ C/30 minutes)?				
	共晶半田対応 Apply for Eutectic solder	リフロー半田耐熱は ALPS 標準プロファイル(別紙 1)にて3回以上を満足しているか Does the component comply the reflow heat resistance (more than 3 times with ALPS standard profile (Appendix 1).)				
	鉛フリー対応 Apply for lead-free solder	リフロー半田耐熱は ALPS 標準プロファイル(別紙 2)にて 5 回以上を満足しているか Does the component comply the reflow heat resistance (more than 5 times with ALPS standard profile (Appendix 2).)				
	鉛フリー対応 Apply for lead-free solder	挿入部品のリフロー半田耐熱は ALPS 標準プロファイル(別紙3)にて2回以上を満足しているかDoes the discrete component comply the reflow heat resistance (more than 2 times with ALPS standard profile (Appendix 3).)				
	手位 Is the component Is the component one time at 350°	日Dip 方式は 260℃10 秒 2 回以上 けけ (半田コテ) 方式 260℃10 秒 2 回 and 350℃ 3 秒以上か t subjected to the dip soldering of two times minimum at 260℃ for 10 seconds? subjected to manual soldering of two times minimum at 260℃ for 10 seconds plus ℃ for 3 seconds?				
	(付Does the compone chlorine of 0.2 • (We understand	国素含有率 0.2%の半田を使用しても信頼性上問題ないか 上様書上明記なしの場合は、信頼性上問題なしの解釈とする) ent comply with the reliability requirements, if solder contains the flux with %? I that there is no problem about the reliability, if its descriptions do not exist sing specifications.)	•			
		215℃で規定してあるか ure of 215℃ specified for soldering ability?				
		『分の寸法、位置関係は明確か ons and configurations for soldering area specified clearly?				
		日付け部分の寸法及び公差は明確か ons with tolerances for outside of the component and soldering area specified				

	項,一目	*			理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
	 ・半田付けする部分のメッキ種類、メッキ構造、メッキ厚は明確か ・Are the kinds of plating, the constructions of plating and the thickness of plating for soldering area specified clearly? ・部品吸着面の平坦性は明確か Is the flatness of the top or bottom surface for surface mounting component specified clearly? 				
	・部品強度(固着、たわみ、衝撃)は明確か Are the strength, such mounting, bent and impact specified clearly?				
	車載用 For car Use - 衝撃試験 14,700±1,470m/s²を満足しているか? Does the component comply with the shock test a 14,700±1,470m/s²?				
	・振動試験 10~2000Hz 98m/s²(10G)又は1.5mmを満足するか? Does the component comply with the vibration test (98m/s²(10G)or 1.5mm at 10~2000Hz)?				
	・たわみ試験(たわみ 1mm・毎秒1mm/s 5秒保持)を満足するか? Does the component comply with the bending test(the bending value is 1mm and the keep times				
5	・現品捺印は明確に記載されているか Is the marking on the component specified clearly?				
	・Lot No. 仕様は明確か Is the lot number specification specified clearly?				
6	・現品の寸法は明確か Are the dimensions of the component specified clearly?				
	・リード付き部品のスタンドオフ寸法は明確か Are the dimensions of standoff for component with leads specified clearly?				
7	・静電耐量は明記してあるか Is the resistance to static electricity specified clearly?				
	・静電耐量 はマシンモデル:200Pf 0 Ω 150V以上か Is the component subjected to the resistance of static electricity for machine model, if the 150 volts minimum applies through the resister of zero ohms from the discharge capacitor of 200 Pf?				
	・及び、人体モデル :100Pf 1.5Kω1000V以上か Is the component subjected to the resistance of static electricity for human body, if the 1000 volts or more applies through the resister of 1.5 kohms from discharge capacitor of 100 Pf?				
	・NOの場合、実力値は明記しているか(各ピン毎) If not be subjected, is the ability for each terminal of component specified clearly?				
8	・内部構造図及び材質は明確か Are the internal constructions and materials specified clearly?				
9	・回路ブロック図は記載してあるか Are the block diagrams of circuits specified?				

部品共通仕様項目チェックリスト Generic check list (5/6)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Check		理由(No の場合)
NO.	ltems	Yes	No	N/T	Reasons, if no
10	・等価回路は記載してあるか Are the equivalent circuits specified?				
11	・推薦すべきアプリケーションは記載してあるか Are the recommended applications for circuits specified?	-			
12	テーピング仕様 Taping specifications 実装部品用 For Surface mounting components				
	・JIS C 0806-3 に準じているか Is the taping based on the requirements of JIS C 0806-3 ?				
	・テーピング方向は明確か Is the taping direction specified clearly?				
	・部品とテープエンボスポケット部のクリアランスは明確になっているか Are the clearances between component and embossed pocket of taping specified clearly?				
	・エンボスポケット寸法で、上部、下部の寸法がそれぞれ明記されているか Are the dimensions for top and lower of the embossed pocket specified clearly?				
	・リールの形状、寸法、材質は明記してあるか Are the shape, dimensions and materials for reel specified clearly?				
	・カバーテープの剥離強度は明記してあるか Is the peeling strength for cover tape specified clearly?				
	カバーテープを外しテープを逆さにしたとき、輸送後及び乾燥等の環境下でも、自重で部品が落下できることを仕様書に明記してあるか Is the purchasing specifications specified clearly about that the component can fall headlong naturally from taping in the environment, such dry conditions, when the components were transferred to, tape cover was removed and the component was moved upside down.				
	・静電防止対策はされているかが仕様書に明記してあるか Is the protection to static electricity specified clearly in the purchasing specifications?				
	・リーダー部テープ、及び終端部テープの長さは明記してあるか Are the dimensions of length for leader and end of taping specified clearly?				
	・ペア保証グループ間の区切りの仕様が明記されているか Is the partition for group of pairing specified clearly?				
	・実装上問題ないことは確認されているか。 Is the component confirmed about no problems on surface mounting?				
	B) 自挿部品用 For discrete components ・JIS C 0806-1(アキシャル部品) JIS C 0806-2(ラジアル部品)に準じているか Is the taping based on the requirements of EIAJ (RC-1008B) or JIS C 0805?				

部品共通仕様項目チェックリスト Generic check list (6/6)

NO	項 <u></u>	Check			理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
13	梱包仕様 Packaging specifications ・輸送時、落下等の諸性能を満足する梱包仕様になっているか(海外輸送も含む) Does the packaging comply with any requirements of packaging, such drop etc. for the transportation including oversea shipping?				
	・静電防止策は袋内および梱包トレイ内で問題ないか Are the bags or tray satisfactory for protection to static electricity?				
	・防湿梱包から取り出された部品は30℃60%~80%RHで2週間以上放置された後、実装されても問題はないか Are there any problems after the period for two weeks or more at 30℃, 60%~80%RH, if the component was took out from the packaging with humidity protection?				
	・防湿梱包は下記が明記されているか Are the specifications for packaging with humidity protection specified clearly about followings?				
	・開封後実装完了までの部品の使用期間、条件 Any conditions and period of an exposure between opening the package and the mounting the components				
	・防湿梱包された部品の保存条件(温度、湿度、期間)が明記してあるか Storage conditions, such temperature, humidity and period, for packaging with components	•			
	・上記条件から外れる場合、開封後の部品のベーキング条件 Baking specifications, if required because of no keeping the above conditions				
14	・生産場所は明記してあるか Is the manufacturing location specified clearly				
	・海外にある場合は工程別に明記してあるか Is the manufacturing location specified clearly on the each process of production, if the manufacturer exists in outside of Japan?				

品種別仕様項目チェックリスト	半導体	品目名称	
Individual checklist	Semiconductor	Part name	

	項 目 Check C		理由(No の場合)		
NO.	ltems	Yes	No	N/T	Reasons, if no
I C					
	・X-Talを使用して発振させるICの負性抵抗は1kΩ以上で規定しているか Is the negative resistance of IC with crystal oscillation specified for at least 1 kohm?				
Ì	・レギュレーターは雑音電圧のMAX値規定化してあるか Is the maximum noise voltage of regulator specified?				
•	・MIX ICはビート比の規定化はしてあるか Is the beet ratio of mixer IC specified?				
Ì	・中空モールドの場合仕様書に明記されているか Does the specification specify clearly, if the hollow mold type is used?				
•	・ヒートシンクの場合は明記してあるか Does the construction of heat sink specify clearly, if the heat sink is used?				
-	・寸法及び電気特性の許容値は明確か Are the tolerances for dimensions and electrical characteristics made clearly?				
	・モールドバリ等の規定は明確か(特に CSP, BGA 等) Are the any projections from molding specified clearly? (Especially, for CSP, BGA etc.)				
IC	Integrated Circuit C4(BGA, CSP) Type				
	・裏面(鏡面)ダイシング側面のチッピングは、A寸法、B寸法共に100μm以下と規定されているか				
	C寸法はL/3以下と規定されているか。				
	For the chipping on the backside (polishing side) and the dicing side, is the allowable chipping size at A and B in below figure specified as				
	100 μ m Max?				
	And is the allowable chipping size at C specified as 1/3 of the length of the bare die?				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	L 裏面 Backside C				
	B				
	・表面傷、パターン傷の大きさが明記されているか。		П		
	Is the allowable size of the scratch on the surface and the pattern specified?]]	

	項 . 目		Check		理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
	• BGA 部以外の異物、汚れの大きさは、バンプ隣接間距離の 1/4 又は、弊社実装基板パターン間(弊社技術より提示)の 1/2 のいずれか小さい方を規定している事 The maximum size of the foreign matter and the dirt on the area except BGA is specified to the smaller one which is either 1/4 of the distance between the bumps or 1/2 of the patterns of ALPS PWB (presented by ALPS design engineer).				
	• BGA 部の汚れ基準:フラックス残渣を含む汚れは BGA 径の 30%以下と規定されている事 The criterion for the dirt on BGA: The maximum area being covered with the dirt (including the residual flux) is specified to less than 30% of the BGA diameter.				
	・半田付け性評価基準が規定されているか Request to add the soldering ability evaluation condition into the specification 前処理条件:MSL 相当の条件を加える Pre-treatment: Specify the condition equal to MSL in the specification 半田ペースト : ロジン系フラックス含有の半田ペースト solder paste: It should include rosin flux リフロー条件:ALPS リフロープロファイル Reflow condition: ALPS reflow profile 判定:全ての BGA と基板半田ランド接合部に cold joint 無き事 Judgment: Every solder ball should connect to PCB. No cold joint (snowman phenomenon) is allowed.				
	・裏面に電極が無い場合、鏡面仕上であり、研磨に使用する砥石番号は#1500以上が 規定されているか If there's no electrode on the backside, is the surface of the backside polished? And is the grinding stone for polishing backside surface specified to more than #1500?				
	・ダイの外形と厚み寸法と公差が明記されているか Is the dimension of the die configuration and the thickness made clear with the tolerance?				

	項 目		Check		理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
	• 抗折強度が 500Mpa 以上であること。				
	Does the specification require the component should have enough body strength to satisfy 500Mpa?				
	・PAD 強度が 1N/1PAD 以上であることが明記されているか				
	Is the PAD strength specified to above 1N/1PAD?				
	・ポリイミドパシベーション素材の製造メーカ名、品番が明記されているか				
	Are the manufacturer name and part number of the material of polyimide passivation made				
	clear?				
	・ボールシア強度30g f 以上と規定されている事				
	Is the ball shear strength specified to minimum 30gf?				
	ポリイミパシベーション or BCB が有りと規定されている事				
	Is the specified material of the surface layer either polyimide passivation and BCB?				
	・リールのポケット内寸法が、製品挿入時、半田ボール部が、リールのポケット内面に				
	接触しない寸法が規定されている事				
	Does the specified form of the reel pocket have structure to prevent the solder ball				
	from touching the internal pocket?				
	・半田バンプの材質は、鉛フリーである事。				
	Is the material of the solder bump lead-free?				
	・ポリイミドパシベーションの厚みと公差が規定されているか。(4μm+/-2μm)				
	Is the thickness of the Polyimide Passivation and its tolerance made clear				
	$(4 \mu \text{m} + / - 2 \mu \text{m})$?				
	・SIN パシベーションの厚みと公差が規定されているか。				
	Is the thickness of the SIN passivation and its tolerance made clear?				
	・コプラナリティ:30μm以下である事が規定されているか。				
	Coplanarity: Is the specified maximum size 30μ m?				
	・バンプボイドの大きさ:バンプ径の30%以下と規定されているか。				
	The size of the void on bump: Is it specified as less than 30% of the bump diameter?				

NO.	項 目 Ltoma	V	Check	N /T	理由(No の場合)
NU.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
	・トレイ仕様が、明確に記載されているか。 Is the specification relating to tray made clear? 1) 耐熱温度 Heat resistance 2)表面抵抗 Surface resistance 3)トレイの外形寸法 Outer dimension of the tray 4)トレイのポケット寸法、ポケット寸法は、製品寸法の10%以内又は、+0.3mm以内のいずれか小さい方を満足する事。 The dimension of the pocket: It should satisfy the smaller one either within 10% of the die size or within +0.3 mm. 5)トレイのポケット高さ寸法、ポケット高さ寸法は、製品高さ寸法の0.1-0/+0.1mmを				
	満足する事 The height of pocket: It should be 0.1-0/+0.1mm higher than the bare die.				
	・最小梱包単位に次の事が記載されている事(ロットNO,数量、品名、品目番号、社名) The description that lot number, quantity, Part name, part number and manufacturer should be made clear in the smallest packing unit.				
	・製造工程プロセスチャートが記載されている事 The manufacturing process chart should be made clear.				
トラ	ランジスター Transistor				
	・hfeのランク(IDSS)、hfeレシオ、は明確か Are the hfe rank (Idss) and hfe ratio made clearly?				
	・寸法及び電気特性の許容値は明確か Are the tolerances for dimensions and electrical characteristics made clearly?				
	・静電耐量は明記されているか Is the resistance to static electricity specified clearly?				
	・モールドのバリ等の規定は明確か Are the projections from molding specified clearly?				
ダイ	イオード Diode				
	・逆耐電圧の規定は明記されているか Is the inverse dielectric voltage withstand specified clearly?				
	・同一テーピング中でペア使用が行われる時のペアリング規定、条件が明確になっているか Are the specifications and conditions for paring use specified clearly, if the components are used in paring in the same taping?				
	・寸法及び電気特性の許容値は明確か Are the tolerances for dimensions and electrical characteristics made clearly?				

品種別仕様項目チェックリスト	水晶振動子&水晶発振器	品目名称
Individual checklist	Crystal Unit & Crysal Osillater	Part name

	項 目 Check				理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	追加の加工が必要な場合、部品に対するストレスの注意が規定されているか				
	Are the any cautions for stress gave to component specified, when additional processing				
	is required?				
2	リード付きの場合の半田付けは根元より 0.6mm 以上になっているか、又は基板厚さ以内か				
	Is the area to be soldered specified to have 0.6 mm minimum from root of lead, or to have dimensions				
	of thickness of PWB?				
3	発振周波数、オーバートーン次数、周波数許容偏差、温特は明記しているか	_	_	_	
	Are the oscillation frequency, overtone degree, frequency tolerance and temperature				
	characteristics specified clearly?				
4	等価直列抵抗 (CI) は明記してあるか (T)				
	Is the equivalent series resistance (CI) specified clearly?				
5	ドライブレベルに対するCI, △CIは規定化しているか				
	Is the CI and △C I against drive level specified?				
6	負荷容量、並列容量、絶縁抵抗、副振動の規定化はされているか				
	Is the load capacitance, parallel capacitance, insulating resistance and spurious specified?				
7	周波数再現性は規定してあるか				
0	Is the frequency reproduction specified?				
8	耐衝撃性試験、耐震性試験は規定しているか				
9	Is the impact test and vibration test specified? 気密性試験は規定してあるか				
9	双省性和映は規定してあるが Is the sealing test specified?				
10	リフロー前後のfo変化、CI変化は規定してあるか				
10	Are the changes for f0 and CI under the conditions of both no soldering and soldered specified?				
11	リフロー後を初期としたときの経時変化(常温放置、高温放置)による特性の変化は規定してあるか				
11	Are the any variations for characteristics specified, if the components which been soldered in				
	reflow process were exposed at room temperature and at high temperature?				
12	ケースへの半田付けの可否は明確か				
	Is the soldering ability to case made clearly?				
13	落下に対しては規定しているか				
	Is the dropping off test specified?				
14	リード部の材質、表面処理は明記してあるか				
	Are the materials and surface treatments for leads specified clearly?			V	

NO.	項 目 Items		Yes	Check No	N/T	理由(Noの場合) Reasons, if no
15	[民生用]周波数再現性 [Consumer use] Frequency reproducibility $-20^{\circ} \sim +85^{\circ} \sim$ 用波 Free = f: $+25^{\circ} \sim$ +25 $^{\circ} \sim$ +25 $^{\circ} \sim$ +25 $^{\circ} \sim$ +3	皮数再現性=f2-f1、f3-f2 equency reproducibility °2-f1,f3-f2				Nodoone, 11 no
	Free	皮数再現性=f2-f1、f3-f2 equency reproducibility '2-f1,f3-f2				
16	E民生一般]衝撃試験 基板(10mm×10mm×0.8mmFR-4)にマウント後、高さ1m、負荷100gにて6面×1 Consumer, general Impact test	o the board on the concrete th plain (Total 6 times) O 回コンケリート床面に落下する。 o the board on the concrete				

	項 目	理由(No の場合)			
NO.	Items	Yes	Check No	N/T	Reasons, if no
17	[民生一般]単品落下テスト 製品単品を 90cm の高さよりコンクリート床面に 3 回自然落下させる。 [Consumer, general] Drop Impact test Drop the product itself 3 times on the concrete floor from the height 90cm. [民生用ハンディタイプ] 単品落下テスト 民生一般に準ずる [Consumer, handy type] Drop impact test In accordance to [Consumer, general]				
18	ER生用]振動試験 基板(10mm×10mm×0.8mmFR-4)にマウント後 振動周波数:10~55Hz 掃引 時間:1分(10Hz~55Hz~10Hz) 全振幅:1.5mm 掃引方向:X,Y,Z 試験時間:各方向2時間 [Consumer use] Vibration test After the device is mounted on a board (10mm×10mm×0.8mmFR-4) Vibration frequency: 10~55Hz Sweep time: 1 min. (10Hz~55Hz~10Hz) Amplitude: 1.5mm Direction: X,Y and Z Test times: 2 hours in each direction				
19	[車載用]単品落下試験 製品単品を 90cm の高さよりコンクリート床面に3回自然落下させる [Car use] Drop impact test Drop the product itself 3 times on the concrete floor from the height 90cm.				
20	同族主納入仕様梱包状態 落下床面:コンクリート 落下高さ:1m 落下方向:1角,3稜,6面 落下回数:各1回 落下方法:自然落下 [Consumer use and Car use] Package drop test Packing: According to package specification Drop on the concrete floor. Height: 1m Direction: 1 corner, 3 edges, 6 plains Drop time: once in each direction Drop way: Drop without load and force				

	項 目		Check				理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no		
21	[民生用,車載用]輸送試験 荷姿:納入仕様梱包状態 試験方法:1)トラック輸送 2)距離:片道 950Km(相馬一大阪間) 3)3 往復 [Consumer use and Car use] Transportation stress test Packing: According to package specification Test condition: 1) Truck delivery 2) Distance: 950 Km as one way (Between Soma - Osaka) 3) 3 round trips						
22	[民生用,車載用]経年変化 弊社技術要求値 [Consumer use and Car use] Changing by time passing According to the specified spec required by your design						
23	[民生用,車載用]低励振レベル特性検査 御社、弊社で合意された規格設定とする [Consumer use and Car use]Low drive level characteristic inspection According to the spec agreed by you and ALPS.						
24	[民生用,車載用]端子曲げ強度(リート・付き) 試料の本体を固定し、端子の軸に垂直方向に下表の重りをつり下げ、90 度曲げた後、除々に元の位置の戻す。 試験終了後、試料に破損があってはならない。 [Consumer use and Car use] Terminal bending strength (applicable for the device having leads) Fix the body of the sample and hang the specified weight below vertically to the axis of the terminal. After the terminal was bent at right angle (90°), return it to the original position gradually. 断面積(mm2) 線径(mm) 荷重(N) Cross section area Diameter Load 0.05 < S ≤ 0.07 0.25 < d ≤ 0.3 1.25 0.07 < S ≤ 0.2 0.3 < d ≤ 0.5 2.5 0.2 < S ≤ 0.5 0.5 < d ≤ 0.8 5						
25	[民生用,車載用]固着性(SMD) 10N,10 秒間保持 [Consumer use and Car use] Adherence force (SMD) It should withstand 10 N for 10 sec.						

	項 目		Check		理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
26	[民生用,車載用]半田付け端子メッキ構造 1) メッキ構造が記載されている事 2) 下地にNi メッキがある事 [Consumer use and Car use] Soldering terminal plating 1) The plating construction should be identified clearly 2) The base material should be Ni plated				
27	[民生用,車載用]半田付け端子メッキ厚 1) Ni メッキ厚: MIN2μm 2) 半田メッキ厚: MIN3μm 3) Au メッキ: MIN0.05μm 4) Ag のみの場合:MIN11μm [Consumer use and Car use] Soldering terminal plating thickness 1) Ni plating thickness: MIN2μm 2) Solder plating thickness: MIN2μm 3) Au plating: MIN0.05μm 4) If terminal is plated by Ag only: MIN11μm				
28	[民生用]端子半田ディップ表面未処理範囲 1) リード根元より 0.6mmMAX が記載されている事 [Consumer use] The area not coated by solder on the terminal 1) It should be identified to 0.6mm MAX from the root of the lead.				
29	[車載用]半田付けリード端子の表面半田未処理範囲 1) リード根元より 0.6mmMAX が記載されている事 [Car use] The area not coated on the terminal 1) It should be identified to 0.6mm MAX from the root of the lead.				
30	[民生用,車載用]SMD 側面電極寸法 電極立ち上がり寸法が記載されている事 [Consumer use] SMD type Side electrode dimension The height of the coating from the bottom should be identified.				

NO	項目		Check		理由(No の場合)
NO.	tems tems TRANT TRAN	Yes	No	N/T	Reasons, if no
31	 [民生用,車載用]半田濡れ性 (1)共晶半田使用時(Dip 方式で評価) 1) 温度:215℃±3℃(許容差も記載している事) 2) 時間:3±0.3秒(許容差も記載している事) 				
	3) ヌレ率:95%以上 (2)鉛フリー半田使用時(Dip 方式で評価) 1) 温度:240℃±5℃(許容差も記載している事) 2) 時間:3±0.3秒(許容差も記載している事) 3) ヌレ率:95%以上				
	[Consumer use, car-use] Solder wet-ability (1) Eutectic solder (Evaluate by Dip solder)				
	 Temperature: 215℃±3℃(Tolerance should be identified.) Time: 3±0.3 sec. (Tolerance should be identified.) Soldered area: More than 95% 				
	 (2) Lead-free solder (Evaluate by Dip solder) 1) Temperature: 240℃±3℃(Tolerance should be identified.) 2) Time: 3±0.3 sec. (Tolerance should be identified.) 3) Soldered area: More than 95% 				
32	[民生用, 車載用] 基板(全端子)平坦度				
	1) MAX 50μ m				
	[Consumer use, car-use] Board (all terminal) coplanarity 1) MAX 50 μ m				
33	ER生用] たわみ試験 基板:100×40×1.6mm(単層) 荷重治具:厚さ:20 幅:50 先端:R230(mm) たわみ 1mm 毎秒 1mm/s 5秒保持 [Consumer use] Bending test Baord:100×40×1.6mm(Single layer) Loading jig:Thicnkess:20 Width:50 Tip:R230(mm) Bending 1mm 1mm/s per second Keep for 5 sec.				
34	[民生用]気密性 (1) ヘリュームガスにる微小リーク:御社基準が仕様化されていること (2) 気泡等による大リーク:御社基準が仕様化されていること [Consumer use] Leakage (1) Minute leakage of helium gas: Your standard should be identified in the product specification. (2) Large leakage of air bubble: Your standard should be identified in the product specification.				

NO	項,目		Check		理由(No の場合)
NO .	tems	Yes	No	N/T	Reasons, if no
35	[車載用]気密性 (1)スローリーク:御社基準仕様化されている事				
	(2)グロスリーク:御社基準仕様化されている事				
	[Car use] Leakage				
	(1) Slow leakage: Your standard should be identified				
	(2) Gross leakage: Your standard should be identified				
36	[民生用]半田耐熱				
	(1)リフロー半田耐熱				
	1) ALPS 標準(共晶半田対応) ピーク 240℃3 回				
	2) ALPS 標準(鉛フリー対応) ピーク 260℃5 回 (2) 手半田				
	(2) 子平山 1) 350℃3 秒以上				
	(3)Dip 半田				
	1) 260℃10 秒 2 回以上				
	(4) エアヒーター				
	1) 300℃5 秒以上				
	[Consumer use] Solder heat resistance	_		_	
	(1) Reflow solder	Ш		Ш	
	1) ALPS standard (Eutectic solder) Peak 240°C 3 times				
	2) ALPS standard (Lead-free solder) Peak 260℃ 5 times (2) Solder by hands				
	1) 350°C for 3 sec. or more				
	(3) Dip solder				
	1) 260°C for 10 sec. 2times or more				
	(4) Air-heater				
	1) 300°C for 5 sec. or more				
37	[民生用]静電耐量				
	1) マシンモデ ル: 200PF 0Ω 150V 以上				
	2)人体モデル:100PF 1.5kΩ 1000V以上 [Consumer use] Electro static resistance				
	[consumer use] Electro static resistance 1) Machine model: 200 PF 0 Ω 150V or more	Ш			
	2) Human model: 100PF 1.5k Ω 1000V or more				
	=/ I mind in the interest in t				
38	[民生用]梱包方法				
	マスターカートン、個装箱、最小梱包方法まで明確にし、梱包内に空間が発生する場合は、緩衝剤材の使用を				
	明確にする。				
	[Consumer use] Packaging specification				
	The packaging specification for master carton, packing carton and minimum packing should be				
	identified. Using fillings (buffers, cushions) to fill the space in the packing should be mentioned.				
	mentioned.				

	項 目	Check			理由(Noの場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
39	[民生用]防湿梱包有り品 開封後~実装完了迄 2週間以上 保管雰囲気:+30℃ 60~80%RH [Consumer use] The device being packed in the moisture-proof packaging The period from opening package to mounting: 2 weeks or more Ambient storage condition: +30℃ 60~80%RH				
40	[民生用]梱包ラベル 品名と ALPS 品目番号があること [Consumer use] Packing label Part description and ALPS part number should be mentioned.				
41	[車載用]梱包ラベル 部品メーカー品名、ALPS 品目番号、ロット NO があること [Car use] Packing label Part manufacturer name, ALPS part number and lot number should be mentioned.				
42	[民生用]生産場所 生産工場の所在地記載 [Consumer-use] Manufacturing location The address of the manufacturing site should be identified.				
43	[民生用]位相雑音(TCXO) 弊社技術要求値 [Consumer use] Phase noise (TCXO) According to the specified spec required by your design				
44	[車載用] 位相雑音(TCXO) 弊社技術要求値が仕様化されている事 [Car use] Phase noise (TCXO) Your design required spec should be identified in the product specification.				
45	[民生用,車載用]製品方向性 方向性の有無、有りの場合は目視判断可能方法で明記されている事 [Consumer use, car-use]Direction of the product Please identify if the product has direction. If yes, the direction enabling to visually judge should be identified.				
46	[民生用,車載用]環境物質 下記内容が記載されている事 [Consumer use, car-use] Inclusion of environmental hazardous substances The sentence below should be mentioned. 1) 日本文 本部品は『アルプス電気株式会社グリーン調達基準書』に定める環境物質の環境基準に適合しています。 2) 英文 This product conforms to the provisions on control of "Environmental hazardous substances" in "Alps electric Co. green procurement standard"				

品種別仕様項目チェックリスト Individual checklist SAW-F·SAW-R SAW filter/SAW resonator 品目名称 Part name

	項 目		Check		理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	リード線の半田付け範囲は根元より 0.6mm 以上になっているか、又は基板厚さ以内か				
	Is the area on the leads for soldering at least 0.6 mm from root of lead, or to have the thickness of PWB?				
2	ケースへの半田付けの可否は明確か				
	Is the soldering ability to case made clearly? 中心周波数は明記してあるか			Ш	
3	中心向仮数は切託してめるパー Is the center frequency specified clearly?				
4	通過帯域の伝送特性(30dB B/W,リップル、チルト)は規定しているか				
	Are the transmission characteristics (30dB B/W, ripple and tilt) for passing band specified?	_			
5	バンド幅の定義は明確か (ex: 3dB B/W) Is the definition for bandwidth made clearly? (ex: 3dB B/W)				
6	通過帯域のディレイ特性(グループディレイ、リップル、うねり) は規定しているか				
	Are the delay characteristics, such group delay, ripple and swelling, for passing band specified? 阻止帯域の特性(減衰量、スプリアス、劝ト特性)は規定しているか	-			
7	阻止情域の特性(微装重、ヘノリノへ、パー特性)は規定しているが Are the characteristics of attenuation, spurious and skirt character for rejection band			Ιп	
	specified?				
8	通過させる信号レベル規定は問題ないか Is the specification for passing signal level appropriate?				
9	信号レベルの最大定格は規定されているか				
	Is the maximum rating for signal level specified?				
10	耐DC印加の規定はされているか			П	
11	Is the dielectric voltage withstand for DC application specified? 気密性の仕様を入れているか	_			
11	Is the sealing ability specified?				
12	ピークバレーの規定はしているか (SAW-R)				
13	Are the peak and valley specified? (SAW resonator) 共振抵抗の規定はしているか (SAW-R)				
15	Is the resonance resistance specified? (SAW resonator)				
14	温度特性、並列容量、共振周波数は規定しているか(SAW-R)]]	
	Are the temperature characteristics, parallel capacitance and resonance frequency specified? (SAW resonator)				
15	機械的強度(耐震、引張り、落下、曲げ)の規定は問題ないか				
	Is the mechanical strength (vibration, elongation, drop and bend) appropriate?				
16	リード部の材質、表面処理は明記してあるか				
	Are the materials of lead and surface treatment specified clearly?				

品種別仕様項目チェックリスト セラミックフィルター・セラミックトラップ 品目名称 Individual checklist Ceramic filter/Ceramic trap Part name

	項 目	項 目 Check			理由(No の場合
NO.	Items	Yes	No	N/T) Reasons, if no
1	両面スルーホール基板に対応可否は明記されているか				
	Does the purchasing specification allow to use the components for the double sided PWB with through				
	holes?				
2	グループディレイの規定をしているか				
	Is the group delay specified?				
3	リップルの規定化をしているか				
	Is the ripple specified?				
4	信頼性の仕様は明確か(振動、落下も含める)				
	Are the reliability specifications including vibration and drop made clearly?				
5	リード線の半田付け範囲は根元より 0.6mm 以上になっているか、又は基板厚さ以内か				
	Is the area on the leads for soldering at least 0.6 mm from root of lead, or to have the thickness				
	of PWB?				
6	リード付きの場合、樹脂ダレ規定は問題ないか				
	Is the specification for the projections dropped off from molding appropriate, if the component				
	has the leads?				
7	リード付きの場合、フラックス進入防止されているか				
	Does the component have the protection against flux invasion, if leads are provided?				

品種別仕様項目チェックリスト チップコンデンサー 品目名称 Individual checklist Chip capacitor Part name

	項 目		Check		理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	リフロー半田耐熱仕様はALPS製造仕様を満足しているか叉リフロー5回以上対応可能か				
	Does the heat resistance specification of reflow soldering comply with ALPS's manufacturing				
	specifications?				
	(Is the component acceptable to be high temperature soldering at +260°C, and to be reflow soldering				
	for five times or more?)				
	鉛フリー対応半田+260° Cに対応可能か 叉リフロー5回以上対応可能か				
2	最大定格電圧、温度係数、容量値範囲、許容差、 t a n δ, Q, 絶縁抵抗は明確か				
	Are the ratings of maximum voltage, temperature coefficient, capacitance range, tolerance, tan				
	δ , Q and insulating resistance specified clearly?				
3	端子電極はハンダメッキ、又はすずメッキになっているか				
	Are the electrodes on the terminals plated with solder, or tin?				
4	固着強度の規定は5 N以上になっているか				
	Does the specification of the strength for adhesive specify to be at least 5 N?				
5	衝撃強度は明記しているか				
	Is the strength for impact made clearly?				
6	梱包袋は静電防止仕様の規定になっているか				
	Does the specification for packaging specify about static electricity?				
7	カバーテープは静電防止対策がされているか				
	Does the cover tap have the protection of static electricity?				
8	半田耐熱の最大定格を明記しているか			Ιп	
	Is the maximum rating of temperature and times for soldering specified clearly?				
9	手付け半田時の条件は明確か				
1.0	Are the conditions for manual soldering made clearly?				
10	B及びF特性付き高容量 コンデンサの場合、バイアス特性は規定されているか				
	Are the bias characteristics specified, if high capacitance capacitor has the characteristics				
	of "B" and "F"?				

品種別仕様項目チェックリスト	チップインダクター	品目名称	
Individual checklist	Chip inductor	Part name	

	項 目	Check			理由(No の場合)
NO.	ltems	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	リフロー半田耐熱仕様はALPS製造仕様を満足しているか又リフロー5回以上対応可能か				
	Does the heat resistance specification of reflow soldering comply with ALPS's manufacturing				
	specifications?				
	(Is the component acceptable to be the high temperature at +260°C, and to be the reflow soldering				
	for five times or more?)				
	鉛フリー対応半田+260°Cに対応可能か 叉リフロー5回以上対応可能か				
2	許容電流は明確か				
	Is the allowable current specified clearly?				
3	端子電極はハンダメッキ、又はすずメッキになっているか				
	Are the electrodes on terminals plated with soldering, or tin?				
4	リフロー回数によってインダクタンスが下がるものある場合、規定化しているか				
	If the inductance would become lower by repeating reflow soldering, is its value specified				
	clearly?				
5	カバーテープは静電防止対策がされているか				
	Does the cover tap have the protection against static electricity?				
6	固着強度の規定は5 N以上になっているか				
	Is the specification of the strength for adhesive at least 5 N?				
7	手付け半田時の条件は明確か				
	Is the condition for manual soldering made clearly?				

品種別仕様項目チェックリスト Individual checklist

I F T Intermediate Frequency Transformer

品目名称	
Part name	

	項 目		Check		理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	コアトルク仕様は規定されているか (初期、リフロー後トルク)				
	Is the specification for core torque measured on initial and after soldering specified?				
2	フラックス進入によるコアトルク大にならない仕様か				
	Does the specification specify that the core torque does not increase, due to invade the flux?				
3	線種、巻数は明確か				
	Are the kinds of wire and winding numbers specified clearly?				
4	コア位置は明確か				
	Is the position of the core specified clearly?				
5	熱によるコアトルク変化は規定されているか				
	Does the specification for the change of core torque caused by heating specified?				
6	モールドにリード線が食い込まない仕様か				
	Does the specification specify about that the leads shall not cut into the molded part?				

品種別仕様項目チェックリスト	チップ抵抗	品目名称	
Individual checklist	Chip resister	Part name	

	項目	項 目 Check			理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	リフロー半田耐熱仕様はALPS製造仕様を満足しているか (高温半田 +260℃ にも問題ないか、又リフロー5回以上対応可能か) Does the heat resistance specification of reflow soldering comply with ALPS's manufacturing specifications? (Is the component acceptable to be high temperature at +260℃, and to be reflow soldering for five times or more?)				
2	最大定格電圧、温度係数、抵抗値範囲、許容差は明確か Are the ratings of maximum voltage, temperature coefficient, resistance range and tolerance specified clearly?				
3	端子電極はハンダメッキ、又はすずメッキになっているか Are the electrodes on the terminals plated with soldering, or tin?				
4	静電耐量を明記しているか Is the resistance to static electricity specified clearly?				

品種別仕様項目チェックリスト	可変コンデンサー	品目名称
Individual checklist	Variable capacitor	Part name

	項 目	Check			理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	トルク仕様は規定されているか(初期、リフロー後トルク)				
	Is the specification for the torque measured on initial and after soldering specified?				
2	フラックス進入によるトルク大にならない仕様か				
	Does the specification specify that the torque does not increase, due to invade the flux?				
3	セッティングドリフトの容量変化は規定されているか				
	Is the drift of capacitance specified, when the capacitance set in the required point?				
4	可変部分の調整穴は図示されているか				
	Are the adjustment holes provided in variable part illustrated?				

品種別仕様項目チェックリスト	貫通コンデンサー	品目名称
Individual checklist	Feedthrough capacitor	Part name

	項目	Check			理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	最大定格電圧、静電容量、許容差、 t a n δ , Q , 絶縁抵抗、温特は明記されているか				
	Are the ratings of the maximum voltage, the capacitance, the tolerance, tan δ , Q and the insulating				
	resistance specified clearly?				
2	芯線の傾きは規定化してあるか				
	Is the slant of core wire specified?				

品種別仕様項目チェックリスト Individual checklist

イメージセンサー Image Sensor

品目名称 Part name

NO	項 目		Check		理由(No の場合)
NO.	Items	Yes	No	N/T	Reasons, if no
1	・寸法及び電気特性の許容値は明確か Are the tolerances for dimensions and electrical characteristics made clearly?				
2	・モールドバリ等の規定は明確か(特に CSP, BGA 等) Are the any projections from molding specified clearly? (Especially, for CSP, BGA etc.)				
3	・パターン傷の大きさが明記されているか。 Is the allowable size of the scratch on the surface and the pattern specified?				
4	・バンプの異物、汚れの大きさは、バンプ隣接間距離の 1/4 又は、弊社実装基板パターン間(弊社技術より提示)の 1/2 のいずれか小さい方を規定しているか Are the maximum size of the foreign matter and the dirt specified to the smaller one, either 1/4 of the distance between the bumps or 1/2 of the patterns of ALPS PWB (presented by ALPS design engineer)?				
5	・裏面に電極が無い場合、鏡面仕上であり、研磨に使用する砥石番号は#1500以上が 規定されているか If there's no electrode on the backside, is the surface of the backside polished? And is the grinding stone for polishing backside surface specified to more than #1500?				
6	・ダイの外形と厚み寸法と公差が明記されているか Is the dimension of the die configuration and the thickness made clear with the tolerance?				
7	・抗折強度が 500Mpa 以上であること。 Does the specification require the component should have enough body strength to satisfy 500Mpa?				
8	・PAD 強度が 1N/1PAD 以上であることが明記されているか Is the PAD strength specified to above 1N/1PAD?				

NO.	項 目 Items	Yes	Check No	N/T	理由(Noの場合) Reasons, if no
9	・ポリイミドパシベーション素材の製造メーカ名、品番が明記されているか Are the manufacturer name and part number of the material of polyimide passivation				
10	made clear? ・ポリイミドパシベーションの厚みと公差が規定されているか。 $(4\mu\text{m+/-2}\mu\text{m})$ Is the thickness of the Polyimide Passivation and its tolerance made clear $(4\mu\text{m+/-2}\mu\text{m})$?				
11	・SIN パシベーションの厚みと公差が規定されているか。 Is the thickness of the SIN passivation and its tolerance made clear?				
12	・コプラナリティ: 弊社技術提示の寸法を規定されているか。 Coplanarity: Is the size provided by our design engineer specified?				
13	・バンプボイドの大きさ:バンプ径の 30%以下と規定されているか。 The size of the void on bump: Is it specified as less than 30% of the bump diameter?				
14	・カバーガラス表面の外観仕様(傷,汚れ,異物)が規定されているか。 Is the allowable appearance (scratch, dirt, foreign matter) of the cover glass ?				
15	・カバーガラスのチッピングサイズが規定されているか。 Is the allowable chipping size of the cover glass ?				
16	・気密性の仕様を入れているか。(カバーガラスとセンサー間) Is the sealing ability soecified ? (between cover glass and sensor)				
17	・リフロー前後の感度変化を明記しているか。 Are the changes for sensitivity under the conditions of both no soldering and soldered specified?				
18	・カバーガラスの材料の製造メーカー名、品番が記載されているか。 Are the manufacturer name and part number of the cover glass material made clear?				

NO.	項 目 Items	Yes	Check	N/T	理由(No の場合) Reasons, if no
NU.	I Leilis	res	No	N/T	Reasons, II no
	・静電耐量は明記してあるか Is the resistance to static electricity specified clearly?				
20	・静電耐量 はマシンモデル: $200 pF$ 0 Ω $200 V$ 以上か Is the component subjected to the resistance of static electricity for machine model, if the 150 volts minimum applies through the resister of zero ohms from the discharge capacitor of 200 pF?				
	・及び、人体モデル : 100pF 1.5kΩ2000V以上か Is the component subjected to the resistance of static electricity for human body, if the 1000 volts or more applies through the resister of 1.5 kohms from discharge capacitor of 100 pF?				
	・NOの場合、実力値は明記しているか(各ピン毎) If not be subjected, is the ability for each terminal of component specified clearly?				
21	 ・トレイ仕様が、明確に記載されているか。 Is the specification relating to tray made clear? 1)耐熱温度 Heat resistance 2)表面抵抗 Surface resistance 3)トレイの外形寸法 Outer dimension of the tray 4)トレイのポケット寸法、ポケット寸法は、製品寸法の10%以内又は、+0.3mm以内のいずれか小さい方を満足する事。 The dimension of the pocket: It should satisfy the smaller one either within 10% of the die size or within +0.3 mm. 5)トレイのポケット高さ寸法、ポケット高さ寸法は、製品高さ寸法の0.1-0/+0.1mmを満足する事 The height of pocket: It should be 0.1-0/+0.1mm higher than the bare die. ・最小梱包単位に次の事が記載されている事(ロットNO,数量、品名、品目番号、社名) The description that lot number, quantity, Part name, part number and manufacturer should be made clear in the smallest packing unit. ・製造工程プロセスチャートが記載されている事 				
	・ 製造工程プロセステャートが記載されている事 The manufacturing process chart should be made clear.				

NO.	項 目 Items	Yes	Check No	N/T	理由(Noの場合) Reasons, if no
22	・センサー表面の外観仕様(傷,汚れ,異物)が規定されているか。 Is the allowable appearance (scratch, dirt, foreign matter) of the sensor?				
	・リフロー後の湿式洗浄について規定化されているか? Is the wet washing after reflow soldering specified?				
	・洗浄条件: 弊社技術提示の洗浄条件に対応可能か。 Washing condition: Can the component accept the washing condition that our design engineer specified?				
23					